

鉛フリーはんだ参考資料（JEITA 鉛フリーはんだ実用化ロードマップ）

電子機器、電気機器内に使用される接合材料としての「はんだ」について、その中に含まれる「鉛」の環境への負荷が顕著であること、また製品の廃棄・リサイクルへの大きな障害となってきたことを認識し、鉛フリー化を推進すべきこと。

1. 鉛フリー化部位のPb（鉛）含有率は0.1wt%未満とすべきこと
2. 鉛フリーはんだ対応部品のはんだ耐熱性を以下の基準とすべきこと
 - (1) リフローはんだ付け（部品表面温度、又は電極端子部温度を基準とする）
 - a) リフローピーク： 240℃、250℃、260℃ 、 時間 5～10sec
 - b) リフロー回数： 2回
 - (2) 手はんだ付け（こて先温度を基準とする。はんだごては十分な熱容量のあるものを使用する）
 - a) 加熱： 温度 390℃又は 400℃ 、 時間 5～10sec
 - b) 加熱回数： 2回
3. 鉛フリー化を計画すべきこと
 - (1) 耐熱温度
 - (2) 対象部位
 - (3) 時期
 - (4) 代替品
4. 鉛フリー化すべき対象
 - (1) 外部電極・端子の表面処理
 - (2) 内部接続・構成部品・部材